

## 복리후생



### 글로벌 역량강화

화상 및 전화 외국어, 외국어 Intensive 과정,  
사내 TOEIC, JPT 시험, 직무 교육 등



### 경력개발 프로그램 및 보상제도

해외파견 등 글로벌 업무 경험, CDP(직무순환제도) 운영,  
개인별 업무관리목표(MBO)를 통한 코칭과 성과에 따른 합리적인 보상



### 금융지원

사내 새마을금고 입점, 주택자금,  
생활안정자금, 경조금, 자녀 장학금 지원 등



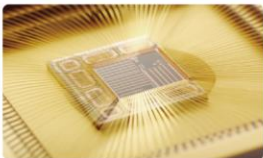
### 의료지원

건강관리실, 근골격계센터, 전문상담실,  
의사 방문 및 무료 진료상담 실시



### 인프라지원

사내 카페테리아 및 북카페 운영, 피트니스 클럽 운영,  
공장 간 셔틀버스 운행, 회사 콘도 지원, 사내 어린이집 운영



[ 고용노동부 ]  
“일자리 창출 유공 표창”

[ 한국장애인고용공단 ]  
“트루컴퍼니(장애인고용 신뢰기업) 금상”



인재경영 | 기술혁신 | 고객지향 | 상생경영

엠코코리아 채용  
카카오 채널



국내 1위 반도체 후공정 기업



Together we create the future

# 엠코코리아



# 최초에서 최고로, Global OSAT Leader



엠크테크놀로지코리아(주)(이하 엠크코리아)는 1968년 한국 기업 최초로 반도체 사업에 착수한 아남산업이그 전신입니다.



또한, 반도체 100년 기업으로의 도약을 위해 안전 송도에 세계 최고 수준의 R&D센터와 최첨단 반도체 패키징 생산라인을 구축하며, 전 세계 11개국 30,000여 명의 임직원과 함께 세계시장 점유율을 1위로 끌어올릴 준비를 하였습니다.



특히, 4차 산업혁명으로 인해 반도체 패키징 시장의 경쟁이 치열해지면서 엠크코리아는 글로벌 경영 환경을 갖추고, 무결점 품질 등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다.

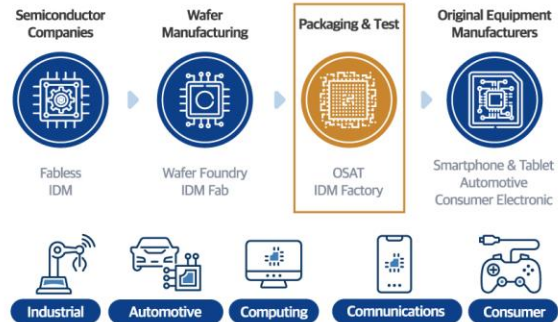
엠크코리아는 적극적인 우수인재 채용을 통해 이러한 경쟁력을 더욱 강화하고 회사와 임직원의 동반성장을 이끌고 있습니다.

## OSAT Outsourced Semiconductor Assembly & Test

반도체 산업은 간략하게 반도체를 설계하는 Fabless, 설계된 반도체를 생산하는 Foundry, 생산된 웨이퍼를 패키징하고 테스트하는 OSAT으로 구분됩니다.

엠크코리아는 반도체 후공정으로 불리는 OSAT 시장에서 세계 최고의 기술력을 바탕으로 미래를 대비한 핵심 Advanced packaging 기술 - Heterogeneous & 3D Integration, System in Package, RF module and system, Advanced logic and RF test, 5G antenna, Automotive 분야에서 시장을 선도하고 있습니다.

특히, 반도체 미세화에 따라 반도체 칩과 회로의 효율적인 배열, 적층 방식의 개선을 통한 다기능·고집적 구현의 중요성은 계속해서 커져가고 있으며, Global OSAT Leader인 엠크코리아는 반도체 후공정 기술 발전을 선도하고 있습니다. 엠크코리아에 입사한다면 Global 기업의 구성원으로서 미국, 유럽, 아시아 등 다양한 사람들과 일하게 되고 해외에서 일할 기회도 얻을 수 있습니다.



## Global Amkor



## 국내사업장

| 부평사업장                              | 광주사업장                                 | 송도사업장  |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                    |                                       |  |
| 면적 : 13,223m <sup>2</sup> (4,000평) | 면적 : 439,669m <sup>2</sup> (133,000평) | 면적 : 185,689m <sup>2</sup> (56,000평)             |
| • TEST<br>• Dropship               | • Assembly<br>• TEST                  | • Amkor's Global R&D Center<br>• Assembly • TEST |

## 전형절차

### 지원방법

- 당사 홈페이지(recruit.amkor.co.kr)에서 온라인 지원

### 전형절차



※ 각 전형절차는 변경될 수 있으므로, 실제 입사지원 시 채용공고에서 확인

## 주요직무소개

| 직무                    | 업무내용  | 관련전공                              |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| R&D                   | • 신규 제품개발 및 공정 관련 개발업무<br>• 고객의 Project 수행 및 기술적 대응   | 공학, 자연계열                          |
| Process Engineer (PE) | • 반도체 Package 생산라인 최적화 공정 구축<br>• 고객요청을 실현하기 위한 기술지원 및 공정설계   | 공학, 자연계열                          |
| TEST Engineer (TE)    | • 반도체 디바이스 양산 TEST 지원<br>• TEST 환경 개발 및 신기술 도입  | 공학, 자연계열 (전기, 전자 관련 우대)           |
| Quality Engineer (QE) | • 품질보증(품질 Issue 대응 및 예방)<br>• 원소재 품질관리<br>• 신뢰성 분석  | 공학, 자연계열                          |
| 생산기획 (IE)             | • Capacity Planning<br>• System & Data Analysis<br>• 표준 설정 및 공장합리화  | 전공무관 (산업공학 관련 우대)                 |
| 고객만족 (PCS)            | • 제조, 물류, 고객 Coordination<br>• Production Control<br>• 고객관리 및 Communication   | 전공무관 (외국어 우수자 우대)                 |
| 구매                    | • Substrate(PCB) 및 Other Direct Material(ODM) 구매, 조달<br>• Substrate, ODM 시장조사<br>• PO Planning 및 납기관리<br>• 가격협상과 신규업체 발굴 등 원가경쟁력 확보 | 전공무관 (외국어 우수자 우대)                 |
| 자동화                   | • 공장자동화에 필요한 장비 등 SW 개발   | 컴퓨터공학, 시스템공학 (장비자동화 SW 활용 가능자 우대) |
| 제조장비직 (Maint)         | • 제조장비 유지 및 보수관리<br>• 공정품질 및 Yield 향상<br>• 프로세스 개선 및 장비가동을 향상   | 전문학사 이공계열 (전기, 전자, 기계 관련 우대)      |
| 제조직 (Operator)        | • 반도체 패키징 및 제품생산<br>• 제품검사 및 품질검수<br>• 컴퓨터를 활용한 장비조작 등 업무   | 고졸 이상 전공무관                        |